

上海证券交易所

上证公函【2019】3103号

关于对江苏长电科技股份有限公司有关 投资设立合资公司事项的问询函

江苏长电科技股份有限公司：

近日，你公司披露关于控股子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.（以下简称星科金朋）与关联方共同投资设立合资公司及相关进展的公告。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

1. 根据公告，合资公司注册资本为 50 亿元，星科金朋以其拥有的 14 项晶圆 Bumping 封装和晶圆级封装专有技术及其包含的 586 项专利所有权出资 9.5 亿元，占注册资本的 19%。上述无形资产组合计账面价值为 6,309,912.62 美元，评估值为人民币 9.51 亿元。请公司补充披露：（1）上述无形资产评估价值的确认依据和具体过程，包括评估假设、参数选择等；（2）说明评估值与账面值存在较大差异的原因和合理性。请评估机构发表意见。

2. 根据公告，交易符合公司对星科金朋新加坡工厂经营策略的调整，有利于其盘活资产，预计将增加非经常性损益，对公司业绩产生较大积极正面的影响。请公司补充披露交易相关的具体会计处理情况、处理依据及合理性，明确对公司业绩的影响，并说明是

否符合会计准则的相关规定。请会计师发表意见。

3. 根据合资经营协议内容，星科金朋需完成标的知识产权的移交或变更登记，其他合资方需分批次完成现金缴付。请公司补充披露：（1）星科金朋在知识产权移交或变更登记过程中需要履行的手续及目前进展；（2）其他合资方目前的出资进展。

请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于2019年12月20日之前披露对本问询函的回复。

